2英寸单晶硅激光切割晶圆激光划片异形加工微孔小孔定制

产品名称	2英寸单晶硅激光切割晶圆激光划片异形加工微孔小孔定制
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	60.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

2英寸单晶硅激光切割晶圆激光划片异形加工微孔小孔定制

华诺激光晶圆切割广泛应用于MEMS、RFID、 CIS等硅基晶圆精密切割。适用于不同厚度的各种外延片,激光切割技术成为LDE行业发展趋势;设备采用1064nm波长
激光器，除可以加工普通厚度晶圆片外,优势在于加工厚度不
超过250um的厚片，提高加工效率并且保证了切割质量。